

常见问题(FQA)

东信源芯微电子有限公司

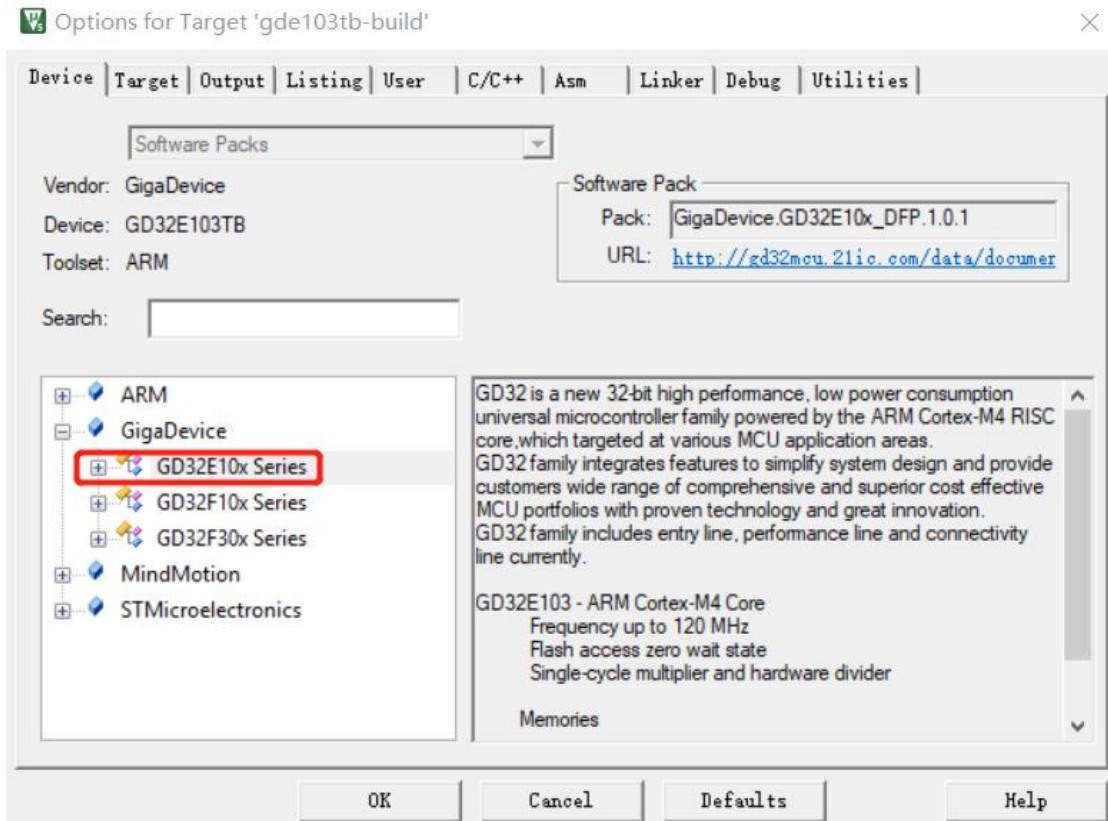
1. keil 中找不到 GD MCU 的支持包

GD 官网资料下载链接：<http://www.gd32mcu.com/cn/download?kw=&lan=cn>

例如：GD32F1 系列 keil 支持包

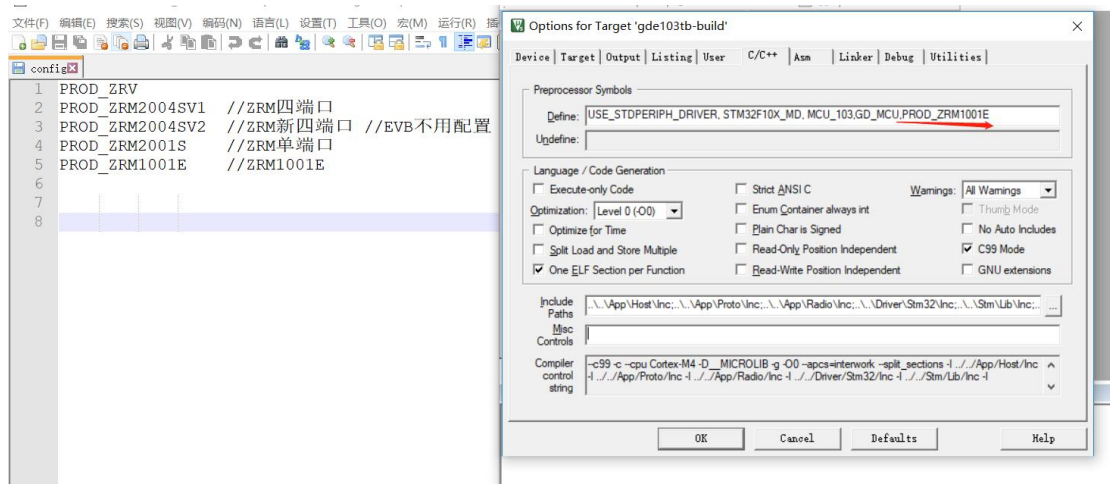
全部资料	包含USB Device驱动库和例程，仅支持 GD32F150 提供 Keil 和 IAR 两种工程，分别在 Keil v4.7x/v5.18a, IAR v7.4 验证通过
GD32F1 MCU	GD32F1x0_ScatterLoading_V3.1.0 3.1 无 2018-02-09 Introduction: GD32F1x0 分散加载例程，支持 GD32F130 / GD32F150 / GD32F170 / GD32F190 例程演示了如何将代码分配到Flash指定区域，参考这个例程，客户可将非关键代码分配到Flash高地址空间。
GD32F2 MCU	
GD32F3 MCU	GD32F1x0_Addon_V3.1.0.rar 3.1 无 2018-02-09 Introduction: 包含三个文件，具体说明如下： 1. GigaDevice.GD32F1x0_Addon.3.1.0.exe Keil4 环境补丁，支持 Keil v4.7x。 2. GigaDevice.GD32F1x0_DFP.3.1.0.pack Keil5 在线支持包，支持 Keil v5.15 及以上版本。 3. IAR_GD32F1x0_ADDON.1.0.2.exe IAR 环境补丁，支持 IAR v7.4 以上版本。
GD32F4 MCU	
GD32E1 MCU	
GD32E2 MCU	
GD32E5 MCU	GigaDevice MCU Multi-port download tool 2.7.0.2480 无 2017-11-14 Introduction: 多串口下载烧录工具。适用于GD32F1/GD32F2/GD32F3/GD32F4/GD32E1/GD32E2/GD32VF1系列MCU
GD32VF1 MCU	

安装完成后，重新打开 keil，显示如下：



2. SDK 编译时，如何指定产品类型

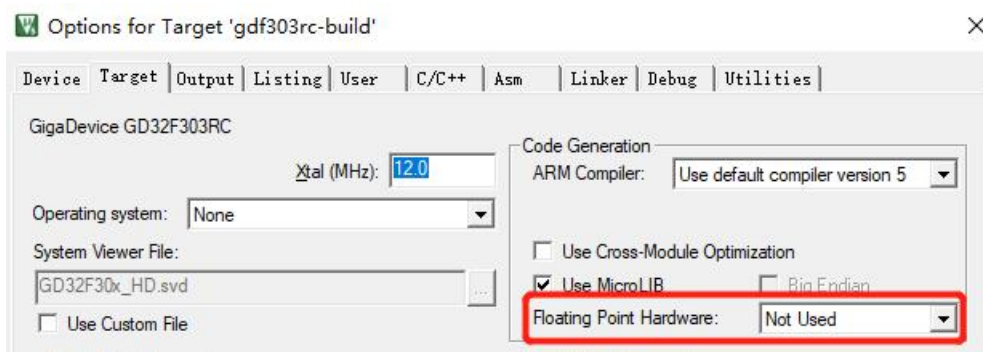
根据 config 文件中的产品宏定义，找出产品对应的类型。在 keil define 中进行设置。
例如，产品型号为 ZRM1001E，设置如下：



3. SDK 运行时，出现 HardFault_Handler 错误，解决方法。

```
/**
 * @brief This function handles Hard Fault exception.
 * @param None
 * @retval None
 */
void HardFault_Handler(void)
{
    /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
    while (1)
    {
    }
}
```

使用 GD 的 MCU，Keil 软件配置需要设置 Floating Point Hardware 为 not used



4. 如何调试 MCU 与 RFID 芯片的 SPI，验证 SPI 工作正常？

SDK 源码中关于 SPI 通信的测试程序。

```
//用于测试SPI与RFID芯片的通信是否正常
void rfid_spi_test(void)
{
    uint8_t data = 0;

    rfes_pcb_power_up(); //打开供电
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_RESET); //RFID芯片复位
    mcu_delay_us(5000);
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
    mcu_delay_us(1000);
    if (rf_powerup_reg() != 0) //对芯片进行上电操作
    {
        printf("rf power up fail\n");
    }

    spi_read_reg(16138, &data, 1);
    //printf("data = [%x]\n", data); //如果data=0x0f,表示spi read正常
    spi_write_reg(16138, 0x08);
    mcu_delay_us(1000);
    spi_read_reg(16138, &data, 1);
    //printf("data = [%x]\n", data); //如果data=0x08,表示spi write正常
} « end rfid_spi_test »
```

main 函数中调用 rfid_spi_test 即可，如下图：

```
int main(void)
{
    mcu_init(); //MCU硬件相关初始化
    rfid_lib_init(); //RFID lib库初始化
    printf("Board Initial OK!!!\n");
    mcu_adc_init(); //ADC初始化
    printf("Parameter Initial OK!!!\n");
    mcu_ext_int_init(); //外部中断初始化
    sw_timer_init(); //定时器初始化
    ucmd_reader_config_init(); //全局配置初始化
    rfid_spi_test(); //测试SPI与RFID芯片通信
    cmd_parser(); //命令解析
}
```

5. 使用 GD 库 SPI 操作时需要注意的问题

SDK 软件中使用的是 ST 的库，操作 SPI 时，直接操作相关寄存器，没有使用 ST 封装 SPI 的相关函数，如下图：

```
/* SPI发送数据 */
static uint16_t spi_send_data(uint16_t data)
{
    while ((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) == (uint16_t)RESET);
    SPI1->DR = data;
    while ((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);
    return (SPI1->DR);
}
```

如果使用 GD 的库，不要直接使用 GD 封装 SPI 的相关函数，自己重新封装函数，直接调用寄存器操作。

注意：调用 GD 封装的 SPI 函数，会导致读取 RFID 芯片寄存器耗时较长，可能会影响标签盘点流程中的时序。

6. 天线检测问题：只连接了一根天线，上位机检测显示连接了 4 根天线。

```
#ifndef PROD_ZRM2004SV1
double g_threshold = 1.0f;
#elif PROD_ZRV
double g_threshold = 3.0f;
#elif PROD_ZRM2004SV2
double g_threshold = -5.6f;
#endif
```

可以调整天线检测阈值 g_threshold，根据新硬件，重新进行适配。

7. 板子遇到 q 值不收敛问题，请问有什么优化建议吗？软件上如果没有问题，硬件上有什么需要检查和注意的吗？

可能是通道的性能比较差，通过两种方式可以确认下：

第一种是用仪器测试下在最大输出功率下的灵敏度

第二在最大输出功率下的接收口的自干扰功率大小

8. select 命令的最小参数长度为什么是 8，协议中是 9 个字节？

```

: // ISO18000-63/EPC commands
: const ucmd_item_t g_arr_cmds_iso[] =
: {
:   {UCMD_CMD_SETISO_COILPRM,      2, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_set_iso_coil_handler},
:   {UCMD_CMD_GETISO_COILPRM,      0, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_get_iso_coil_handler},
:   {UCMD_CMD_INVENTORYISO_CONTINUE,5,UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_inventory_iso_continue_handler},
:   {UCMD_CMD_INVENTORYISO_STOP,   0, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_null_handler},
:   {UCMD_CMD_READISO_TAG,         9, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_read_iso_tag_handler},
:   {UCMD_CMD_WRITEISO_TAG,       10, UCMD_OPT_AIR,      ucmd_write_iso_tag_handler},
:   {UCMD_CMD_LOCKISO_TAG,        6, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_lock_iso_tag_handler},
:   {UCMD_CMD_KILLISO_TAG,        4, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_kill_iso_tag_handler},
:   {UCMD_CMD_SELECTCMDISO_TAG,    3, UCMD_OPT_AIR,      ucmd_select_iso_tag_handler},
:   {UCMD_CMD_ISO_MIN_SENSE,       4, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_min_sens_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_SET_RF_PRM,    6, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_multi_set_rf_prm_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_GET_RF_PRM,    1, UCMD_OPT_FIXLEN | UCMD_OPT_AIR, ucmd_multi_get_rf_prm_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_SET_SELECT,    8, UCMD_OPT_NULL,    ucmd_multi_set_select_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_GET_SELECT,    1, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_multi_get_select_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_SET_QUERY,    4, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_multi_set_query_handler},
:   {UCMD_CMD_MULTI_GET_QUERY,    1, UCMD_OPT_FIXLEN,   ucmd_multi_get_query_handler}
: };

```

1.3.3.13 HSURM_SET_SELPRM (设置 Select 指令参数)

该命令用于设置模块的指定协议的 Select 指令参数，包括“MemBank”、“Target”、“Action”、“Pointer”、“Length”、“Mask”、“Truncate”。各参数的具体应用及含义详见协议说明

➤ 命令格式

HEAD	FC	IL	PAYLOAD								CHECK	
			Protocol	Target	Truncate	Action	Membank	Pointer	Length	Mask		
0xBD	0x0087	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Bytes	1Byte	N-Bytes	1Byte

最少是 8 个字节，只要大于等于 8 字节都是合法的，select 有可能是带 mask。

9. 标签命令里面 UCMD_OPT_AIR 表示主时钟 100Mhz，是什么含义？

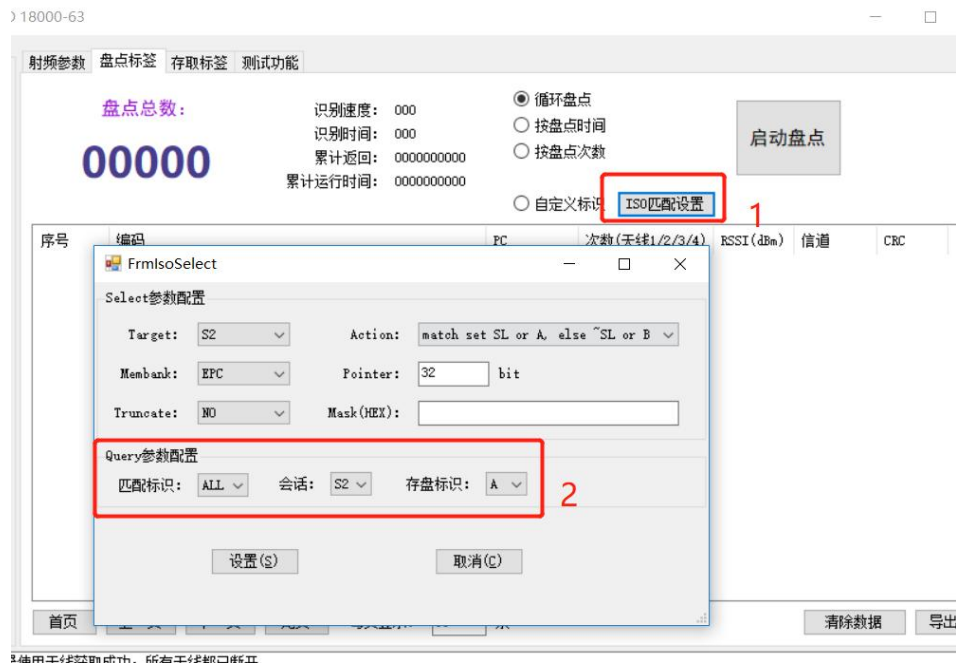
这个宏最早做芯片研发的时候定义的，现在已经不用了，除了那个固定参数的宏，用于接收命令长度检查，其他的没有实际意义的。

10. 目前 inventory 只有 RSSI，是否支持相位的识别？

目前这个芯片不支持相位，下一版芯片会支持

11. 上位机上如何配置 session？

盘点标签页面下进行设置，如下如：



红色框里的盘点，默认 session 为 0，如下图



12. 6C 协议里面只有一个 preamble, SDK 中 dig_set_long_preamble 和 dig_set_short_preamble 长前导和短前导指的是什么?

```
ret_ctrl_e iso_query_command(query_param_t *param)
{
    uint8_t cmd_code=0;
    cmd_buf_t txcmd;
    ret_ctrl_e ret;

    dig_set_fifo_max_level(8);
    dig_set_rxlen(16);
    dig_auto_rx(1);
    txcmd.bits_cnt=0;
    txcmd.bytes_cnt=0;
    cmd_code=0x08;
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&cmd_code, 4);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->dr, 1);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->bleoding, 2);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->trent, 1);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->sel, 2);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->session, 2);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->target, 1);
    common_make_bits_sequence(&txcmd, (uint8_t *)&param->Q_value, 4);

    dig_crc_ctrl(RF_CRC_TX5);

    dig_clr_fifo();
    dig_set_long_preamble();
    dig_start_send();
    dig_set_txlen(txcmd.bytes_cnt*8+txcmd.bits_cnt);
    ret=common_fifo_multi_bytes_write(txcmd.cmd_buf, txcmd.bytes_cnt*8+txcmd.bits_cnt);
    if(ret)
    {
        return ret;
    }
    ret=rfid_irq_wait_resp(g_rdsm_status, RF_INT_STDCMD_OVER);
    if(ret)
    {
        return ret;
    }
    dig_set_short_preamble();
    return RFID_RET_SUCCESS;
} « end iso_query_command »
```

query 命令前面的部分叫长前导码, 其他命令的头部都是短前导码。

dig_set_long_preamble 设置长前导码后, 通过 dig_start_send 发送出去, dig_set_short_preamble 再还原设置为短前导码 (长前导和短前导是控制同一个寄存器, 所以需要设置回去)

13. rf_auxadc_lna_pkdet_result 回波损耗实现机制？

回波检测有两种机制：

内部实现：通过配置芯片寄存器，由芯片检测的，也就是通过 rf_auxadc_lna_pkdet_result 实现。

外部实现：通过 mcu 的 adc 计算来的（SDK 中没有实现）。

具体使用那种方式取决于你们采用那种模块型号的参考设计。

内部的不是对数线性，范围也不够宽，精度和外部比还是有点差距。

14. 不接天线时候，回波损耗为什么很大？

回波测试

测试次数： <input type="text" value="10"/>	回波损耗： <input type="text" value="21.2"/>	dB	<input type="button" value="回波测试"/>
---------------------------------------	---	----	-------------------------------------

不接天线的话回波损耗绝对值会比较小，问题原因可能是板子上的功率检测器的测量电路有问题。

15. 关于回波损耗的计算、回波损耗在什么范围内，说明阻抗匹配是合适的？

```
/* 回波损耗测试,使用芯片内部adc */
static int16_t ucmd_reader_backpower_test(uint8_t count)
{
    float backpower=0.0,tmp=0.0;
    uint8_t power = g_rf_config_parameter.txpower;
    float txpower=(float)power;
    int16_t data=0xffff;

    rf_rfp11_freq_cfg(g_tmp_freq); //设置锁相环的工作频率
    power_txpower_cfg(power); //设置功率
    rfid_cw_on(); //开启载波
    rf_auxadc_sample_enable(); //使能auxadc,用于jammer测试
    backpower=rf_auxadc_lna_pkdet_result(count); //通过芯片adc测试反射功率
    if(abs(backpower)<40.0)
    {
        tmp=(txpower-(backpower+10.0))*10.0;
        if(tmp<0)
        {
            tmp=tmp-0.5f;
        }
        else
        {
            tmp=tmp+0.5f;
        }
        data=(int16_t)tmp;
    }
}
```

- 1) 红框中的+10，这个公式是拟合公式，10 是根据芯片特性验证出来的固定参数。
- 2) 回波损耗越大越好，具体是一个相对的范围（驻波比，尽量小，回损尽量大，这样反射回来能量就少。接收效果也好）
- 3) 回波损耗和天线环境有关系，测试时，使用相同的天线进行测试，回波损耗值越大，效果越好。

16. 在关闭载波状态 standby 模式和 shutdown 模式 功耗差距大概有多少？

一般 shutdown 模式下，我们给芯片断电，即功耗基本为 0，standby 模式下功耗大概是 600mw~800mw

17. 关于芯片的功耗模式说明一下？

芯片分为三个模式：standby, txrx, shutdown

txrx 模式：在该模式下进行盘点即标签操作，功耗会高

standby 模式:该模式会关闭芯片内部分电路，sjc，模拟电路等。在该模式下部分配置依然保存

shutdown 模式：给芯片断电，所有配置，上电后需要重新配置

三个模式的功耗情况：txrx > standby > shutdown

状态切换示例代码

从 shutdown 到 txrx:

```
rfes_shutdown_to_standby();  
rfes_standby_to_txrx();  
dig_base_init();  
rf_sjc_init();  
rf_base_dc_meas();  
ucmd_reader_config_set();  
rfes_curr_status_set(RFES_STATUS_TXRX);
```

从 txrx 到 shutdown:

```
rfes_standby_to_shutdown();  
rfes_curr_status_set(RFES_STATUS_SHUTDOWN);
```

从 standby 到 txrx:

```
rfes_standby_to_txrx();  
rf_sjc_init();  
rf_base_dc_meas();  
power_txpower_cfg(power_get_cur_pwr());  
fhss_hopping_freq_config();  
rfes_curr_status_set(RFES_STATUS_TXRX);
```

从 txrx 到 standby:

```
rfes_txrx_to_standby();  
rfes_curr_status_set(RFES_STATUS_STANDBY);
```

18. 关于温度检测和功率补偿的校准方案

基准温度为 36 度

36 - 71 度，每增加 4 度， scal 增加 1

大于 71 度，每增加 2 度， scal 增加 1

36 度以下，每降低 5 度 scal 减 1

我们是这么做的，实际中也不是很准确，仅供参考。

19. 下面红框中的代码是否可以去掉？

```
l152: ..... break;
l153: ..... default:
l154: ..... if (common_status_outtime_check(12000))
l155: ..... {
l156: .....     g_rdsm_status=MAIN_SM_STATUS_END;
l157: ..... }
l158: ..... //printf("default Status=%d\n",g_rdsm_status);
l159: ..... break;
l160: ..... } «end switch g_rdsm_status»
l161: ..... } «end while 1»
l162: .....
```

不能去掉，如果去掉，当状态修改为中断程序执行的状态，而中断不来的情况下，程序会死锁，无法退出。这是规避一些异常情况的。正常情况下不会不来中断。

20. SDK 接口说明文档中，dig_isr_reg_clean、dig_data_isr_clean、dig_data_isr_manul_clean，三个函数的使用有什么区别？

<code>dig_isr_reg_clean</code>
<code>void dig_isr_reg_clean(void)</code>
清除中断寄存器，中断掩码寄存器，中断数据寄存器
无

`dig_isr_reg_clean`，一般初始化的时候需要把所有中断清除一下

<code>void dig_data_isr_clean(void)</code>
清除中断数据寄存器

`dig_data_isr_clean` 盘点过程中，发送命令、接收数据都需要清除的，这个等同于 `dig_data_isr_get()`

`void dig_data_isr_manul_clean(void)`

清除中断寄存器

`dig_data_isr_manul_clean` 清除中断寄存器，一般强制结束盘点时，清除一下

21. 触发 `common_inventory_statis_outtime_check` 的超时保护之后，QueryRep 帧可以正常发送，但是无法接收到芯片的 RN16 回复，请问触发超时后，在不重启 Query 的前提下，如何操作才能使芯片恢复正常呢？

`common_inventory_statis_outtime_check` 里面检查有两个目的：

1. 当一定时间内没有盘点的新标签，就结束盘点。目的是提高盘点效率，没有必要按照碰撞算法一直到盘点结束。
2. 限制了每一个 query 周期的最大时间，就是担心再某些情况下碰撞算法跑飞，永远出不来。

从上面的目的来讲，我们都是加强系统的稳定性的。但这些功能不是必要的。如果觉得多余或者误导你们的思路可以去掉。去掉也不影响正常盘点。

超时后怎么操作能恢复正常？我们认为，既然已经出现超时，那我们就需要重新跳频，重新初始化，开始下一个 query 周期。如果你不想发 query 只是想继续盘点，那这个功能就没有必要用了，可以直接删除掉。你非要再超时的时候想办法恢复继续盘点，那需要检查一下，为什么会超时？根据超时的原因去解决。超时的原因，有多种，可能是碰撞算法异常，环境改变等等。

22. 功率配置的三个参数的取值范围以及推荐取值区间？

```
rf_pa_gain_cfg(5);  
rf_modulator_gain_cfg(2,7);  
dig_dbb_gain_cfg(83);
```

`tx_mod_gain` 取值如下：

```
tx_mod_gain=0    max-14  db  
tx_mod_gain=1    max-8   db  
tx_mod_gain=2    max-6   db  
tx_mod_gain=3    max-3   db  
tx_mod_gain=4    max-6   db  
tx_mod_gain=5    max-3   db  
tx_mod_gain=6    max-2   db  
tx_mod_gain=7    max(8)  db  
-*/
```

tx_pa_gain 取值如下:

```

/*
tx_pa_gain=0      max-24      db
tx_pa_gain=1      max-18      db
tx_pa_gain=2      max-12      db
tx_pa_gain=3      max-6       db
tx_pa_gain=4      max-3.5     db
tx_pa_gain=5      max(12.5)   db
*/

```

scale 值对增益的影响关系如下

$$Y = (\text{scale}/128) * x$$

y 为输出的数字信号幅值

x 为数字信号原始幅度

scale 的值不要超过 140, 否则会波形畸变

23. SDK 接口对于 Q 值传参检查数值为 0 或者大于 15, Q 设置为 4; Q 值不可以设置为 0 吗?

Q 值可以设置为 0, Q 值为 0 应用于单张标签的场景。

24. 一条 read 指令, 在默认配置下 (FCC 下), 理论最多可返回 50 条 read 的结果, 这样设计是否合理, 是否我们的固件设计里, 可以尝试最多读取 50 次, 如果 50 次全部失败, 返回错误, 如果有一次成功就停止反复读取, 这样设计更合理一些, 否则用户使用的时候, 一条指令的响应会是长度不定、次数不定。

我们当前对读的设计是, 指定单张标签读取时, 如果失败, 会跳频继续读, 直到一次读取成功, 整个读操作退出。如果未指定标签读取, 也就是多标签读取时, 不管标签成功或者失败, 都会继续下次读取, 直到所有频点都跳一次, 而且标签信息不会重复上报, 固件中有过滤机制。

25. read 读取响应中 STATUS 和 TagStatus 有什么关系?

➤ 响应格式及状态字节

HEAD	FC	IL	STATUS	PAYLOAD								CHECK
				TagStatus	Antenna	CRC	PC	UILength	UII	WordCount	Data	
0xBD	0x005E	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte	2Bytes	1Byte	N Bytes	1Bytes	N-Byte	1Byte

STATUS: 表示模块成功接收到标签响应数据

TagStatus: 表示标签返回的操作状态

只有上面 2 个标志同时成功，才表明读取成功。

26. dig_set_fifo_min_level(3)表示什么含义?

```
ret_ctrl_e common_fifo_multi_bytes_write(uint8_t *p_buf, uint16_t bitcnt)
{
    uint16_t bytecnt;
    uint16_t cnt = 0;
    ret_ctrl_e ret;

    bytecnt = (bitcnt+0x07) >> 3;

    if(bytecnt>RF_FIFO_MAX_WRITELEN)
    {
        dig_data_isr_manul_clean();
        dig_set_fifo_min_level(3);
        dig_intr_mask(RF_INT_MASKs(~(RF_INT_FIFO_ALMOST_EMPTY_EDGE_PL)));

        while(bytecnt > RF_FIFO_MAX_WRITELEN)
        {
            dig_fifo_write(&p_buf[cnt], RF_FIFO_MAX_WRITELEN);
            ret = rfid_irq_wait_resp(g_rdsn_status, RF_INT_FIFO_ALMOST_EMPTY_EDGE_PL);
            if (ret)
            {
                return ret;
            }
        }
    }
}
```

芯片的发送机，从 FIFO 中取数据，当取的小于等于 3 个字节时，发出将要空的中断 (RF_INT_FIFO_ALMOST_EMPTY_EDGE_PL)，提示应用层继续给 FIFO 中写入数据。

27. 以下各种情况下如何产生外部中断?

1. 在合适的时间范围内，单一标签返 RN16,且射频芯片接收到正确的 RN16;
RN16 成功接收到，会产生接收完成中断 (RF_INT_RX_END_PL)
2. 在合适的时间范围内，由于标签冲突，多个标签同时返回 RN16,导致无法解出任何 RN16;
rn16 无法解析，会产生 preamble 错误中断 (RF_PREAMBLE_CHECK_FAIL_PL) 或 pilot 错误中断 (RF_INT_PILOT_FAIL_PL)
3. 在合适的时间范围内，尽管标签冲突，但是射频芯片仍然解出一个错误的 RN16;
rn16 如果能成功解析出数据，这个时候无法判断 RN16 的正确性，只能发送 ACK 走下面的流程，如果 RN16 不正确，标签不会回应 EPC
4. 场内无标签，rx 端信号幅值均在解调阈值之下，相当于在有效的返回时间段内无 RN16 信号;
rn16 空闲情况下，会产生 preamble 错误中断 (RF_PREAMBLE_CHECK_FAIL_PL) 或 pilot 错误中断 (RF_INT_PILOT_FAIL_PL)
5. 射频芯片向空口发送 query 失败;

等待发送结束中断 (RF_INT_STDCMD_OVER), 如果发送 query 失败, 等待会出现超时错误

6. 是否还有其他情况下返回外部中断呢?

发送完成中断 RF_INT_STDCMD_OVER

接收完成中断 RF_INT_RX_END_PL

FIFO 将空中断 RF_INT_FIFO_ALMOST_EMPTY_EDGE_PL

FIFO 将满中断 RF_INT_FIFO_ALMOST_FULL_EDGE_PL